



主要特点

7 位, 步进 0.25dB

工作频段: 0.1~6 GHz

插损: 1.4 dB@2 GHz

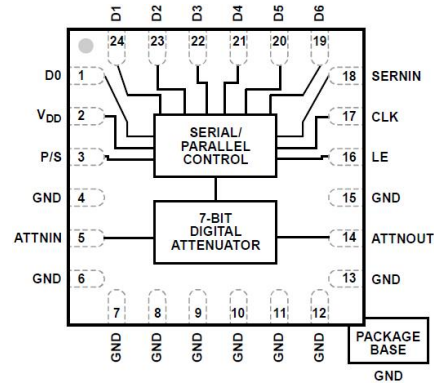
衰减精度: $\pm(0.15+4\%*A)$

P-0.1: 36 dBm

I/O 控制电平: 兼容 1.8V/2.5V/3.3V LVTTTL, 5V TTL

陶封尺寸: 24-Lead, 4mm×4mm QFN

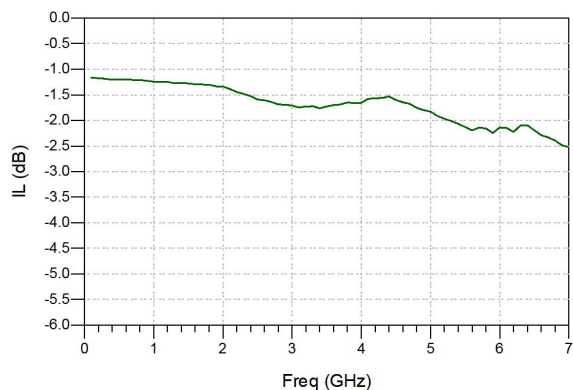
功能框图



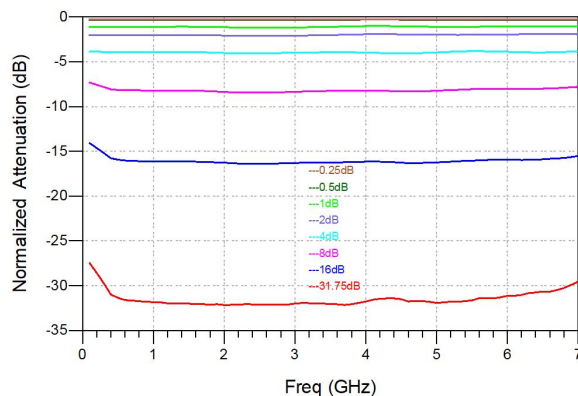
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{DD}=2.5\text{V}\sim 5\text{V}$, 50Ω)

参数	条件		最小	典型	最大	单位
插损	0.1GHz~2GHz			1.4	1.8	dB
	0.1GHz~4.0GHz			1.7	2.1	dB
	0.1GHz~6.0GHz			2.2	2.4	dB
衰减范围				31.75		dB
衰减精度				±(0.15+4%*A)		dB
回波损耗	2GHz			12		dB
	4.0GHz			14		dB
	6.0GHz			12		dB
附加相移	2GHz			15		deg
	4.0GHz			40		deg
	6.0GHz			60		deg
开关时间	导通	50% V _{CTL} to 90% RF _{OUT}		80		ns
	关断	50% V _{CTL} to 10% RF _{OUT}		90		ns
输入功率压缩点	P _{-0.1}			36		dBm
	P ₋₁			36		dBm
工作电压	V _{DD}		2.5		5.5	V
控制电压范围	P/S, CLK, SI, LE, D0~D6		0		V _{DD}	V
控制电压门限电平	Low	V _{DD} =3.0V	0		0.8	V
		V _{DD} =5.0V	0		1.2	V
	High	V _{DD} =3.0V	1.2		3.0	V
		V _{DD} =5.0V	1.6		5.0	V
功耗	V _{DD} =3.0V			150		μA
	V _{DD} =5.0V			200		μA

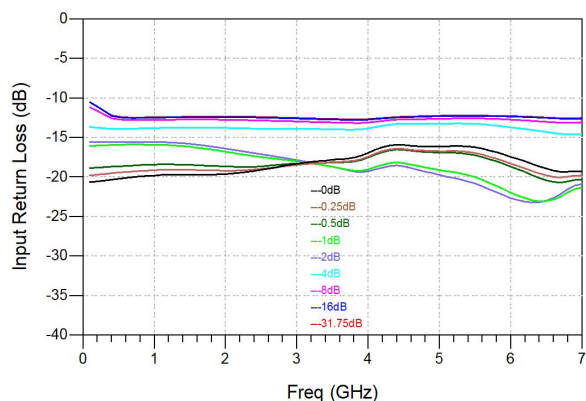
插损



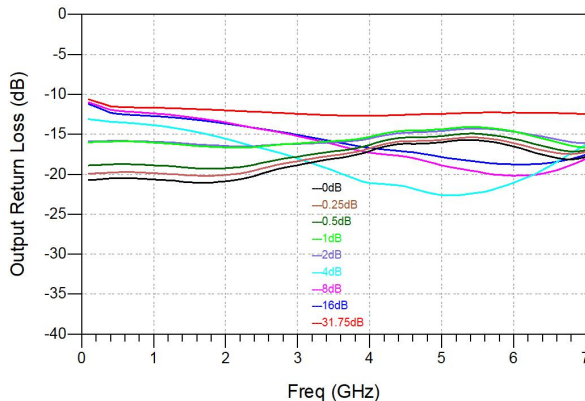
基态衰减量



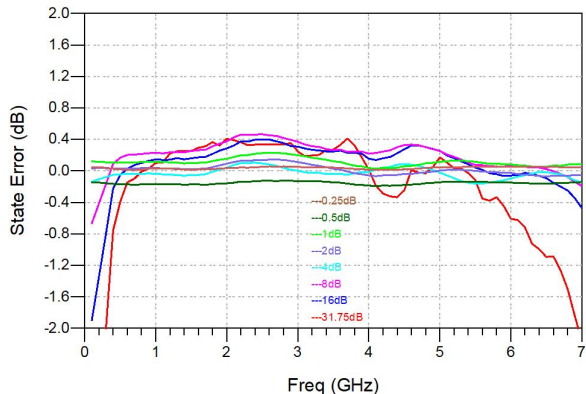
输入回波损耗



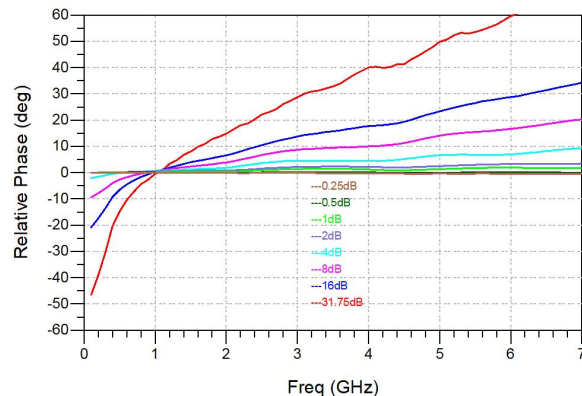
输出回波损耗



衰减精度



附加相移





HGC2001LC4

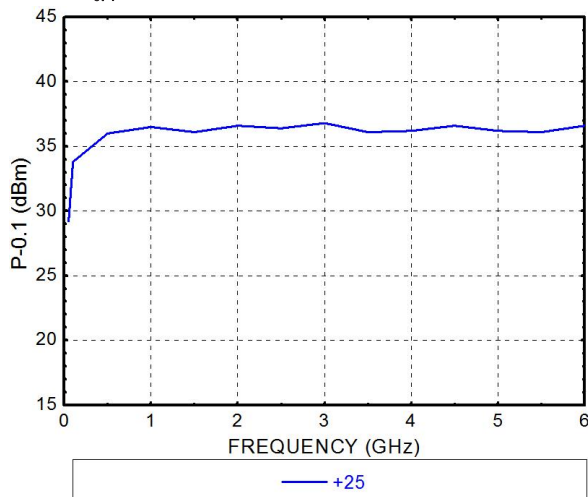
Silicon Digital Attenuator

7 位数控衰减器, 0.1-6GHz

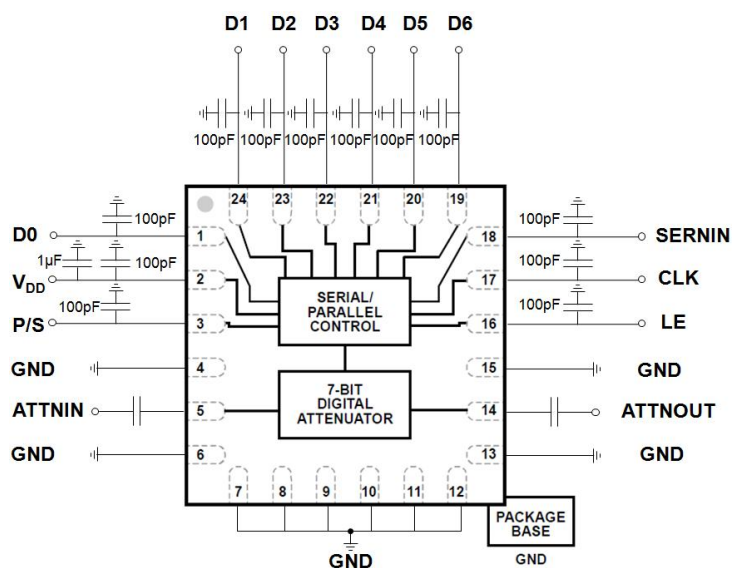
F4

数控衰减器 — 陶封

输入 $P_{-0.1}$



推荐应用电路



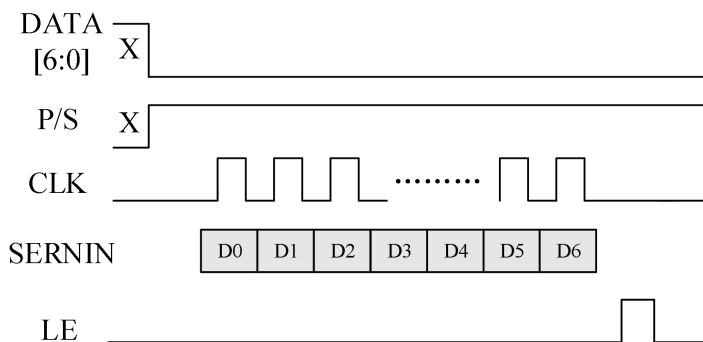
真值表

[illegible]

控制说明

F4

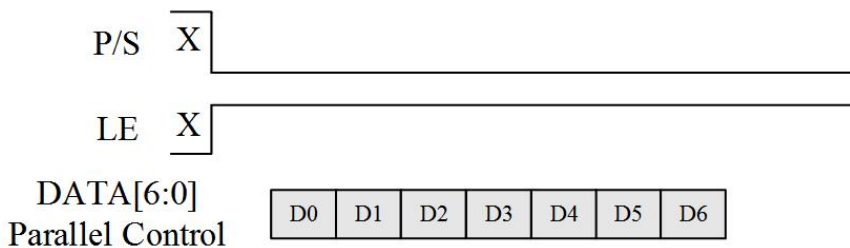
数控衰减器
— 陶瓷封装



串联控制时序图

● 串联控制时序说明

- 1、 串联控制时 P/S 接高电平，DATA[6:0]接低电平；
- 2、 时钟信号 CLK，上升沿有效；
- 3、 数据传输 SI，7 位串行输入，低位优先输入，D0-D6 分别对应各自的衰减位；
- 4、 锁存信号LE高电平有效，在发送完最后一位数据，将LE置为高电平产生一个正脉冲，脉冲宽度大于半个时钟周期，数据将锁存到输出端口；
- 5、 对芯片进行编程控制请以上述时序图和说明为准。



并联控制时序图

● 并联控制时序说明

- 1、 并联控制时 P/S 接低电平，LE 接高电平；
- 2、 LE保持低电平时，数据处于锁存状态，外部数据无法送入寄存器，维持上一状态，LE保持高电平，锁存器开启，数据可以送入寄存器；
- 3、 DATA[6:0]七位控制位分别独立控制各个衰减位。

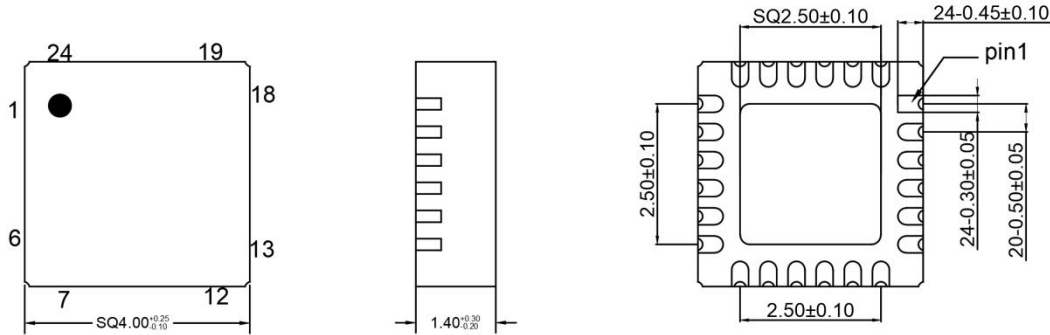
● 上电顺序

- 1、 接 GND；
- 2、 接 VDD；
- 3、 数字控制端口上电；
- 4、 射频端口上电；



物理参数

单位: mm



注意事项:

1. 器件在干燥、氮气环境中存储;
2. 器件对静电敏感, 在储存、运输、储存、装配和使用过程中注意防静电;
3. 所有接地引脚请连接 RF 地;
4. 该产品适用于回流焊贴装工艺, 回流焊温度 $\leq 265^{\circ}\text{C}$, 回流焊使用时需要做去金预处理。

引脚说明

端口序号	功能	描述
1, 19~24	D0, D6~D1	并联控制端口
2	VDD	电源
3	P/S	并行/串行功能控制接口
4, 6~13, 15	GND	地
5	ATTNIN	射频信号输入端, 需外接隔直电容。
14	ATTNOUT	射频信号输出端, 需外接隔直电容。
16	LE	串行/并行锁存接口
17	CLK	时钟信号
18	SERNIN	串行数据输入接口
底部中央焊盘	GND	底部中央焊盘必须连接至 RF/DC 地

极限参数

参数	备注	数值	单位
工作电压	V _{DD}	+5.5	V
控制电压	P/S, CLK, SI, LE, D0~D6	VDD	V
射频输入功率 (全衰态)	T _{CASE} =+85℃	28	dBm
工作温度	-	-55~85	℃
存储温度	T _{stg}	-65~150	℃